

无锡靖芯科技有限公司

2025 年度社会责任报告

关于本报告

报告简介：本报告是无锡靖芯科技有限公司发布的 2025 年社会责任报告。报告以客观、透明为原则，真实反映公司在 2025 年度履行社会责任方面的理念、实践与成效。

报告主体：无锡靖芯科技有限公司（以下简称“靖芯科技”、“公司”或“我们”）。

报告时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为保持信息的连贯性，部分内容可能涉及之前或之后的少量信息。

报告编制依据：本报告参照 GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》、GB/T 36000-2015《社会责任指南》及 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》编制。

数据说明：本报告引用的财务数据来源于公司审计报告，其他数据来源于公司内部统计。

获取方式：本报告电子版可在公司官方网站（www.stbchip.com）查阅下载。

一、公司概况

无锡靖芯科技有限公司成立于 2019 年 9 月，位于江苏省无锡市滨湖区蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 1901-3 室。公司是一家专业从事模拟集成电路、数模混合集成电路以及功率器件等产品研究、开发及销售的高新技术企业。公司注册资本 1060 万元。

公司产品涵盖电源管理、马达驱动、OVP 过压保护、充电管理、功率器件等系列，广泛应用于消费电子、工业控制、智能家居、安防设备、可穿戴设备等领域。公司创始人和核心骨干均具有行业内十几年的从业背景，在深圳设有办事处，为华南客户提供本地化服务。

2025 年，公司持续保持稳健发展态势，营业收入达 7304.58 万元。截至 2025 年底，公司共有职工总数 32 人，研发人员 16 人，占总人数的 50%，其中硕士 2 人，本科 10 人，大专学历 4 人。

二、社会责任管理体系

2.1 社会责任理念

公司始终秉承“做好产品、担好责任”的经营理念，坚持经济效益与社会效益相统一，将社会责任融入企业发展战略和日常运营。公司参照 ISO 26000《社会责任指南》国际标准及 GB/T 39604《社会责任管理体系要求及使用指南》，系统开展社会责任实践。

2025 年，公司在既有社会责任管理体系基础上，进一步完善了社会责任工作机制，明确了各层级在社会责任管理中的职责分工，推动社会责任工作更加系统化、规范化。

2.2 利益相关方沟通

公司持续加强与各利益相关方的沟通交流，通过多种渠道了解并回应各方关切。2025 年，公司重点加强了与客户和员工的沟通频次与深度，客户满意度调查有效回收率达 88.0%。

三、员工责任

3.1 员工权益保障

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，与所有员工签订劳动合同，按时足额缴纳社会保险和住房公积金，切实保障员工合法权益。2025 年，公司进一步完善了薪酬福利体系，为员工提供了更具竞争力的薪酬待遇和更全面的福利保障。

3.2 人才队伍建设

截至 2025 年底，公司共有职工总数 32 人，研发人员 16 人，占总人数的 50%。公司坚持“人才强企”战略，2025 年公司研发团队硕士及以上学历 2 人，本科学历 10 人，大专学历 4 人。公司建立了系统的培训体系，组织专业技能、质量管理、安全生产等多方面培训，设立了清晰的职业发展通道和内部晋升机制。

3.3 员工关怀与文化建设

2025 年，公司持续深化员工关怀工作。公司通过组织各类文化活动和团队建设活动，营造积极向上、团结协作的工作氛围。公司关注员工身心健康，倡导工作与生活的平衡。

2026 年 3 月，公司在“三八”国际劳动妇女节之际，举办了“不被定义，自在发光——靖芯女神节”活动，为女员工送上节日祝福与暖心礼物，营造了和谐、包容、有温度的工作氛围。

3.4 职业健康与安全

公司持续重视员工职业健康与安全，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。2025 年度，公司未发生重大安全生产事故。

四、客户责任

4.1 产品质量保障

公司持续保持 ISO 9001:2015 质量管理体系认证有效运行，认证范围涵盖半导体分立器件（功率器件）、集成电路芯片的设计开发和销售。

2025 年度主要质量指标达成情况：

质量指标	目标值	2025 年实际值
成品一次验收合格率	≥98%	98.5%
平均封测良率	≥97%	97.8%
平均封装周期	≤45 天	≤43 天
质量问题整改闭环率	100%	100%

4.2 客户满意与投诉处理

2025 年度，公司客户满意度综合得分为 **90.3** 分，较 2024 年 85.2 分提升 5.1 分，首次达到并超越公司质量目标≥90 分。各维度得分：质量 91.0 分（↑3.5 分）、价格 86.5 分（↑4.5 分）、交货期 89.0 分（↑5.0 分）、技术咨询 90.5 分（↑4.5 分）、售后服务 92.0 分（↑4.0 分）。

质量投诉典型案例——JX3503AMR-G 混料问题：2025 年 6 月，客户反馈 JX3503AMR-G 定制产品中混有一盘印字为 JD353 的器件，铝箔袋信息与卷盘实物信息不符。公司组织跨部门团队（质量部、销售部、运营部、封测厂），运用鱼骨图和 5Why1H 分析法进行根因分析，确定主要原因包括：标签多打、多余标签未及时清理、贴标签时未核对实物信息、QC 未 100%双重确认。

改进措施：①包装员工贴标签时 100%核对内外标签信息；②QC 100%二次核对标签信息；③控制标签打印数量，不可多打，桌面多余标签及时清空。封测厂于 2025 年 6 月 13 日完成培训，公司安排人员对封测厂包装工段进行审核验证。以上改进措施均已固化至封测厂包装作业规范中，横向展开至同类产品包装工序。

4.3 质量信用建设

2025 年，公司依据 GB/T 31863-2015《企业质量信用评价指标》，结合公司业务特点，建立了系统的质量信用测量体系。体系涵盖基础合规类测量指标（一票否决项）和六大常规分级测量指标，围绕产品/服务质量履约情况、客户和市场反馈、质量合规与责任、质量改进与创新等维度，构建了分层次、可量化的质量信用测量指标体系。

2025 年度质量信用自我评价综合得分为 92 分（满分 100 分），37 项指标中 34 项达成，达成率 91.9%。

五、技术创新与行业贡献

5.1 研发投入与知识产权

2025 年，公司研发费用总额为 502.02 万元，较 2024 年 469.74 万元增长 6.87%，研发投入占比持续保持在 6%以上。

截至 2025 年底，公司累计获得授权知识产权 42 项，其中发明专利授权 9 项（较 2024 年新增 4 项），实用新型专利 4 项，集成电路布图设计 29 项。2025 年度新增发明专利授权 4 项（ZL202211688604.0、ZL202211741059.7、ZL202411981399.6、ZL202310057681.4），新增集成电路布图设计 6 项。

5.2 绿色技术创新

2025 年，公司在绿色技术创新方面取得多项突破。公司申请的“一种有效降低步步进电机振动噪音的控制方法”专利，通过精细控制每一拍的时间间隔和电平信号，将电机振动噪音降低了 30%。该技术已应用于多家企业的生产线，显著提升了设备运行的平稳性和使用寿命。该项技术作为无锡“科技降噪”行动的重要组成部分，为改善城市声环境、践行绿色发展做出了积极贡献。

2025 年度，公司申请的“一种用于 high side 抑制热插拔过程浪涌的结构”专利（公开号 CN119297951A），通过利用齐纳二极管、电阻和 MOS 管的特性，克服了因 MOS 管栅源耐压较低而无法实现 high side 驱动的问题。公司申请的“一种 IIC 通信从机低功耗休眠数字实现方法”专利（公开号 CN119916920A），能够最大限度降低芯片数字模块的休眠功耗。公司主导产品低功耗、高电源抑制比线性稳压器芯片，静态电流仅 3.2-3.3 μ A，低于行业一般水平 40%以上。

5.3 行业标准化参与

2025 年，公司作为主要起草单位之一参与的国家标准《半导体器件 无线功率传输和充电用半导体器件 第 1 部分：一般要求和规范》（计划号：20256397-T-339）进入正式起草阶段，为推动行业标准化发展贡献了靖芯力量。

5.4 行业贡献与产业链协同

公司聚焦高端 LDO 赛道，依托核心团队近二十年的模拟芯片研发积累，已成功开发出可对标国际一线品牌的高性能产品。2025 年公司低功耗、高电源抑制比线性稳压器芯片销售额达 7304.58 万元，国内市场占有率达 7.34%，省内市场占有率达 24.46%，有效推动了高端电源管理芯片的国产化进程。

在产业链协同方面，公司上游链接半导体晶圆制造与封装测试资源，下游服务消费电子、智能家电、工业控制等领域的终端客户，产品已先后成为多家客户的合格供应商，销售网络覆盖长三角和珠三角两大电子信息产业集聚区。

六、公益慈善与社区共建

6.1 员工子女奖学金

2025 年，公司继续开展员工子女奖学金活动，对考入高等学府的员工子女给予奖励，激励员工子女奋发学习、成长成才，体现了公司对员工家庭的人文关怀。

6.2 社区共建

2025 年，公司继续积极参与所在区域的社区共建活动，鼓励员工参与社区志愿服务，以实际行动回馈社会。

七、合规经营与纳税贡献

7.1 守法合规经营

公司严格遵守国家法律法规，依法开展经营活动。2025 年度，公司未发生任何重大质量安全事故、质量行政处罚事件和虚假宣传事件。

7.2 纳税贡献

公司积极履行纳税义务，依法按时足额缴纳税款，为地方财政提供了稳定支撑。2025 年度公司营业收入达 7304.58 万元，资产总额达 4866.40 万元，彰显了稳健的经营能力和社会责任担当。

八、未来展望

展望 2026 年，公司将继续秉持“做好产品、担好责任”的经营理念，在以下方面持续深耕：

持续加大研发投入：围绕低功耗、高可靠性模拟芯片方向持续创新，推动更多核心技术突破和产品落地。

深化质量信用建设：进一步完善质量信用测量体系，对标行业标杆企业，持续提升质量信用水平。

践行绿色发展理念：将绿色设计理念贯穿产品全生命周期，从源头减少环境负荷，为城市环境改善贡献力量。

提升员工幸福感：持续完善薪酬福利体系，丰富员工文化生活，为员工成长提供更广阔的平台。

加大公益慈善投入：持续开展员工子女奖学金等公益活动，积极参与社区共建，践行企业社会责任。

报告日期：2025 年 3 月

